

TIC™800G系列 是一種高性能低熔點導熱界面材料。在溫度50℃，TIC™800G開始軟化並流動，填充散熱片和積體電路板的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。TIC™800G系列在室溫下呈可彎曲固態，無需增強材料而獨立使用，免除了增強材料對熱傳導性能的影響。

TIC™800G系列 在溫度130℃下持續1000小時，或經歷-40℃到125℃的反覆循環測試，其導熱性能仍不會減退。在工作溫度下，其中相變材料軟化的同時又不會完全液化或溢出。



適用於:

- 》高頻率微處理器
- 》筆記本和桌上型電腦
- 》電腦伺服器
- 》記憶體模組
- 》快取記憶體晶片
- 》IGBTs

最小熱阻系列:

- 》0.014℃-in²/W 熱阻
- 》室溫下具有天然黏性, 無需黏合劑
- 》散熱器無需預熱

TIC™800G 系列特性表

產品名稱	TIC™805G	TIC™808G	TIC™810G	TIC™812G	測試標準
顏色	灰色	灰色	灰色	灰色	目視
厚度	0.005" (0.127mm)	0.008" (0.203mm)	0.010" (0.254mm)	0.012" (0.305mm)	*****
厚度公差	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0008" (±0.019mm)	±0.0012" (±0.030mm)	±0.0012" (±0.030mm)	*****
密度	2.6g/cc				氮氣比重瓶
工作溫度	-40℃~125℃				*****
相變溫度	50℃~60℃				*****
定型溫度	70℃ for 5 minutes				*****
熱傳導率	5.0 W/mK				ASTM D5470 (修正)
熱阻抗 @ 50 psi(345 KPa)	0.014℃-in²/W 0.09℃-cm²/W	0.020℃-in²/W 0.13℃-cm²/W	0.038℃-in²/W 0.25℃-cm²/W	0.058℃-in²/W 0.37℃-cm²/W	ASTM D5470 (修正)

標準厚度:

0.005"(0.127mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm) 0.0012"(0.305mm)

如需不同厚度請與本公司聯繫。

標準尺寸:

10" x 16"(254mm x 406mm) 16" X 400' (406mm X 121.92M)

TIC™800G 系列片料供應時附有白色離型紙及底襯墊，模切半斷加工可提供拉手,也可提供模切成單個形狀型試提供。

壓敏黏合劑:

壓敏黏合劑不適用於TIC800™ G系列產品。

補強材料:

無需補強材料。



導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑

加拿大 Canada:

TEL: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com
<http://www.thermazig.com>

台灣 Taiwan:

TEL: +886-2-22771007
E-mail: sales@ziitek.com.tw
<http://www.ziitek.com.tw>

東莞 Dongguan:

TEL: +86-769-38801208
E-mail: sales@ziitek.com
<http://www.ziitek.com>

昆山 Kunshan:

TEL: +86-512-57816297
E-mail: sales@ziitek.com

成都 Chengdu:

TEL: +86-28-62379168
E-mail: sales@ziitek.com